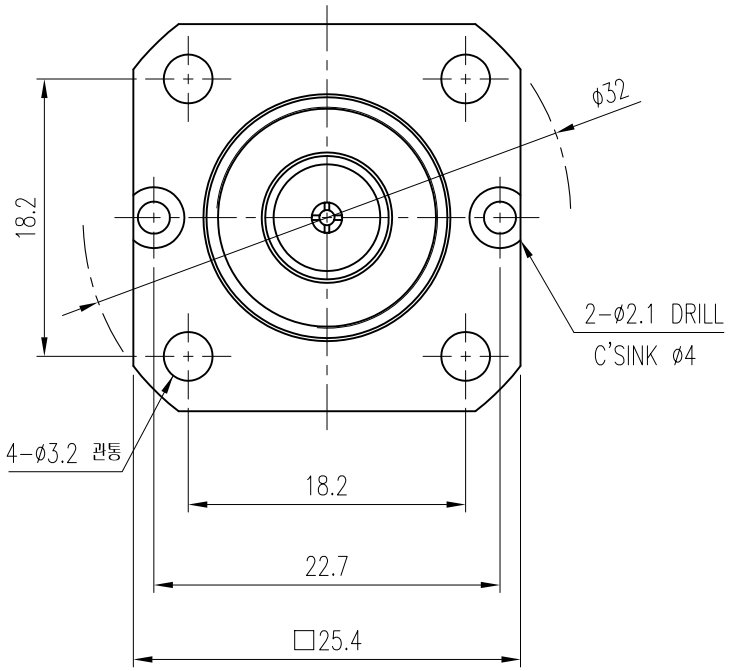
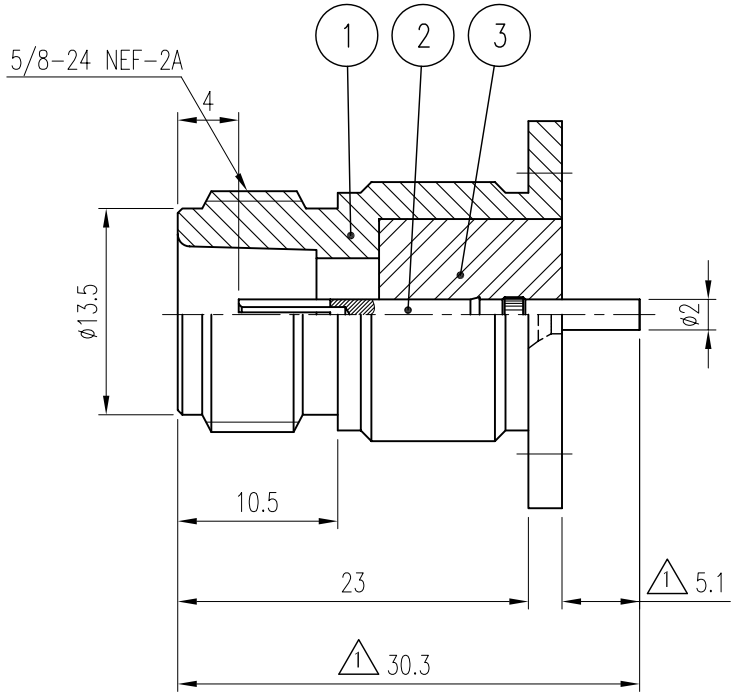
ST \ 가공										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
1	길이 변경	김인철	유일환	2005. 3. 31.





	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
	3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00764-N/1 (H8534)
	2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00801-5/1 (E8532)
	1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD01002-5/1 (D8534)

대체가능재질

공통공차 소수 각도 분수

재질

열처리

보호피막처리

년월일 2005. 3. 9.

승인

검도

제도

직성부서 연 구 소

척도 2/1 단위 mm 중량 —

KJ COMTECH

KJ COMTECH CO.,LTD.

RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 N75-J-H4-R

A4

도번 CN00846-7/1

K347-412-001

주 기

1. 조립시 BODY 플랜지 면에서 절연체가 돌출되지 않도록 할 것.